ソルダーペーストSAC305

S3X58-M500C-7 (Sn 3.0Ag 0.5Cu) Type 4

高濡れソルダーペースト

高濡れ
枕不良抑制
再酸化防止
低ボイド

濡れを極めた、ハイスペック

- 予熱温度上昇による溶融性低下を抑止し、幅広いプロファイルで安定した実装が可能
- 多様な部品材質に対する濡れ性を向上、枕不良・ボイド・はんだボールの発生を抑制
- 微細パターン (0603 チップ、0.25mmφCSP) に対し、良好な溶融性を確保

S3X58-M650-7 (Sn 3.0Ag 0.5Cu) Type 4

ピンコンタクト・洗浄対応ソルダーペースト

ICT対応
洗浄可能
ハロゲンフリー

チェッカーピンに残渣を残さない

- ICT に対応、ピンへのフラックス残渣付着を防止
- チェッカーピンコンタクト性を大幅に改善し、高い測定精度を確保
- 溶融性に優れ、ボイドの発生を抑制、且つ炭化水素系溶剤で洗浄可能
- IPC J-STD-004B 規格で ROL0

クラウンピン

ストレートピン

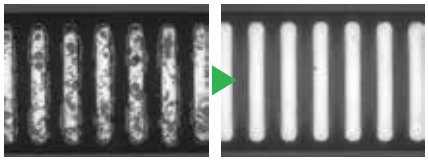
S3X58-HF950W (Sn 3.0Ag 0.5Cu)

水溶性ソルダーペースト（水洗浄対応）

水洗浄可能
ハロゲンフリー

新規技術で洗浄性と作業性の両立を実現

- 純水や水系の洗浄剤を用いてフラックス残渣の洗浄が可能
- 連続使用時の特性変化が少なく、安定した実装が可能
- 繰り返し印刷を行ってもブリッジすることなく良好な印刷形状を保持


洗浄前後の SEM 画像

S3X58-HF900N (Sn 3.0Ag 0.5Cu) Type 4

フラックス残渣高信頼性ソルダーペースト（狭ギャップ実装対応）

高信頼性
N_2リフロー用
ハロゲンフリー

次世代高密度実装を実現

- 0.125mm の狭ギャップパターンでも絶縁抵抗値の低下なし
- N_2 雰囲気リフローで、0603 チップ部品にも良好なはんだ付けが可能